

IE-PCB-SPM-P-180-SMD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SPElink®

**Prises Ethernet à paire simple pour cartes de circuits imprimés**

L'Ethernet à paire unique (SPE) est une technologie qui ne nécessite qu'une seule paire de fils pour transmettre les données et l'alimentation.

Les avantages qui en découlent feront de la SPE le réseau préféré sur le terrain et au-delà.

Avantages de l'Ethernet à paire unique :

- Cohérence : l'Ethernet à paire unique permet une communication Ethernet uniforme du capteur jusqu'au nuage
- A l'épreuve du temps : une technologie clé pour l'industrie 4.0 et l'IdO
- Souplesse : des portées allant jusqu'à 1000 m et des propriétés de transmission allant jusqu'à 1 Gbit/s permettent une utilisation dans toutes les applications
- Innovation : plus léger, moins d'espace requis et un effort d'installation réduit

Informations générales de commande

Version	Connecteurs à équiper, Insert PCB M8, IP67 avec boîtier, Raccordement soudé SMD, 180°, Nombre de pôles: 2
Référence	2795110000
Type	IE-PCB-SPM-P-180-SMD
GTIN (EAN)	4064675119166
Qté.	100 pièce(s)

IE-PCB-SPM-P-180-SMD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	14,5 mm	Profondeur (pouces)	0,571 inch
Hauteur	22,1 mm	Hauteur (pouces)	0,87 inch
Largeur	10,1 mm	Largeur (pouces)	0,398 inch
Poids net	5,14 g		

Températures

Température de fonctionnement	-40 °C...85 °C
-------------------------------	----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-46-02-01	ECLASS 13.0	27-46-02-01

Propriétés électriques

Courant nominal	4 A	Tension nominale	72 V
Tenue d'isolation	≥ 500 MΩ		

Standards

Norme de connecteur	IEC 63171-5
---------------------	-------------

Caractéristiques du système

Angle de sortie	180°	Catégorie	T1-B
Catégorie de puissance	T1-B	Cycles d'enfichage	≥ 100
Degré de protection	IP67 avec boîtier	Famille de produits	Ethernet industriel
Montage sur le circuit imprimé	Raccordement soudé SMD	Nombre de pôles	2
Système de soudure	Soudure par refusion, Soudure manuelle		

Données des matériaux

Matériau isolant	LCP	Couleur	noir
Tableau des couleurs (similaire)	RAL 9011	Tenue d'isolation	≥ 500 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Matériau des contacts	Alliage de cuivre	Surface du contact	Ni/Au
Température de fonctionnement , min.	-40 °C	Température de fonctionnement , max.	85 °C

Emballage

Longueur VPE	327 mm	Largeur VPE	327 mm
Hauteur VPE	52 mm		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

IE-PCB-SPM-P-180-SMD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Téléchargements

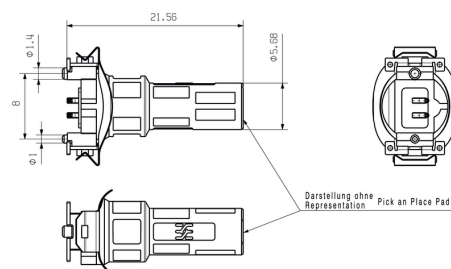
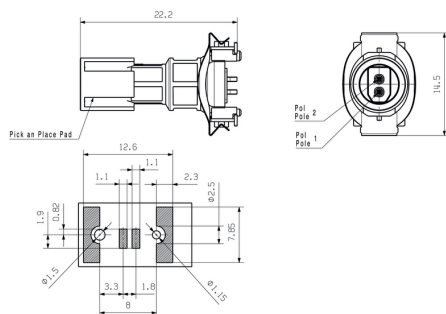
Données techniques	CAD data – STEP
Documentation technique	IE-PCB-SPM-P-180-SMD
Catalogue	Catalogues in PDF-format

IE-PCB-SPM-P-180-SMD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins



Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.